

Pressemitteilung Vortragsveranstaltung der Regionalgruppe Stuttgart am 17.06.2008

Am 17. Juni 2008 fand die diesjährig zweite Vortragsveranstaltung der FED Regionalgruppe Stuttgart unter der Leitung von Herr Oliver Riese, Geschäftsführer der riese electronic GmbH, statt.

Dieses Mal war die Regionalgruppe zu Gast bei der RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH, am Stammsitz in Ispringen. Mit einem Umsatz von 618 Millionen Euro (2007) und seinen über 1.200 Mitarbeitern, ist der Distributor europaweit vertreten. Automotive, Kommunikation, Consumer und Industry sind die mit Halbleitern, passiven Bauelementen und Elektromechanik belieferten Branchen, so erklärte dies Herr Edgar Huber zu Beginn der Veranstaltung in einem Kurzportrait über seinen Arbeitgeber.

Im Anschluss daran begrüßte der Leiter der Regionalgruppe den Gastgeber, sowie die 37 Teilnehmer und stellte den FED (Fachverband für Elektronik Design e.V.) kurz vor. Die vielfältigen Aktivitäten des FEDs, die sich von der Richtlinienarbeit über die Übersetzung der IPC-Normen erstreckt, waren u.a. Inhalt dieser Kurzvorstellung.

Der daraufhin folgende Fachvortrag stieg tief in die Technik ein. „Strombelastbarkeit und Entwärmung von Leiterplatten“ waren Schwerpunkte des von Herrn Oberender (Firma Häusermann) gehaltenen Vortrags. Im ersten Teil des Vortrages gab Oberender einen kurzen Abriss der Wärmeleitungs- und Wärmeabstrahlungsmechanismen und zeigte die sehr unterschiedlichen Wärmekoeffizienten der in der LP-Fertigung eingesetzten Materialien auf. Mit dem zweiten Teil des Vortrag spannte er den Bogen von der Theorie in die Praxis. Die konkreten Umsetzung der Entwärmung von Leiterplatten waren Inhalt dessen. Die Komplexität der Leiterplatten nehme stetig zu, da Bauteile nicht nur auf die Leiterplatte, sondern in diese integriert werden, so Oberender. Dies habe eine Verringerung der Leiterbreite und der Leiterbahnabstände bis zu 75 µm, und zukünftig wahrscheinlich noch weniger, zur Folge. Um die geforderten Funktionen unter Berücksichtigung einer höheren Bestückungsdichte weiterhin zu erfüllen, müssen zukünftig größere Stromstärken über die Leiterbahn geführt werden. Oberender sprach hierbei von einer Stromstärke die zwischen 100 und 150 Ampere liegen. Für die Abführung der Wärme sind grundsätzlich drei Möglichkeiten gegeben, die Wärmeleitung, die Konvektion und die Wärmestrahlung, wobei letztere für die Entwärmung keine große Rolle spiele.

Die anschließenden zwei Fachvorträge wurden von Mitarbeitern des Gastgebers Rutronik gehalten. Thermomanagement war das Thema des ersten Vortrags. Hier wurden Möglichkeiten zur Wärmeabführung auf Baugruppen gezeigt. Die hierfür zum Einsatz kommenden Bauteile reichen von Lüftern bis hin zu Kühlkörpern. Der Referent Roland Hofmann zeigte hierbei unter anderem auf, welche wärmeabführenden Bauteile von Rutronik bezogen werden können.

Der folgende Vortrag behandelte das Thema Traceability (Bauteil-Rückverfolgbarkeit). Schwerpunkte waren hier die Herausforderungen an einen europaweit agierenden Distributor, sowie die Antwort von Rutronik auf diese Forderung des Automotive-Bereichs. Die größte Herausforderung bei der Einführung von Traceability sei es, unter Einsatz von automatisierten Scannern, die richtige Lesbarkeit der Barcodes sicherzustellen. Wenn die Bauteile, mit einem Barcode markiert, über ein Förderband laufen, so können diese in jedem Winkel liegen. Das richtige Lesen, egal in welche Richtung der Barcode zeigt, ist unabdingbar für eine funktionierende Rückverfolgbarkeit der Bauteile. Aber auch diese Hürde hat der Distributor erfolgreich genommen, so die Referentin Dr. Jasmin Stahl

Einen runden Abschluss fand die Vortragsveranstaltung in der Diskussion der gehörten Vorträge und einem Ausblick des Regionalgruppenleiters auf zukünftig stattfindende Vorträge und Veranstaltungen des FEDs. Ganz besonders wies er noch einmal auf die FED-Konferenz hin, die in diesem Jahr im September in Bamberg stattfinden wird.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

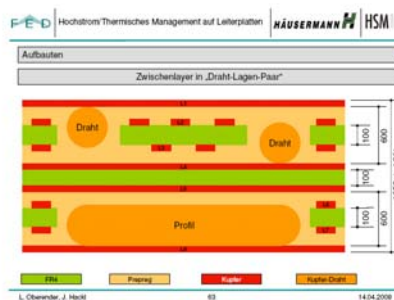
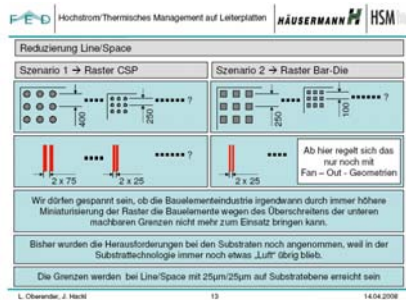


Bild 1: Herr Oberender der Firma Häusermann bei seinem Vortrag Strombelastbarkeit von Leiterplatten

Bild 2: Die Referenten (v.L.): Edgar Huber (Rutronik), Oliver Riese (riese electronic GmbH), Lothar Oberender (Häusermann), Dr. Jasmin Stahl (Rutronik), Roland Hofmann (Rutronik).

Bild 3: Die 37 Teilnehmer der Vortragsveranstaltung der RGS lauschen gespannt den Vorträgen.

Bild 4: Präsentationsauszug „Reduzierung Line/Space“

Bild 5: Präsentationsauszug „Zwischenlayer in Draht-Lagen-Paar“